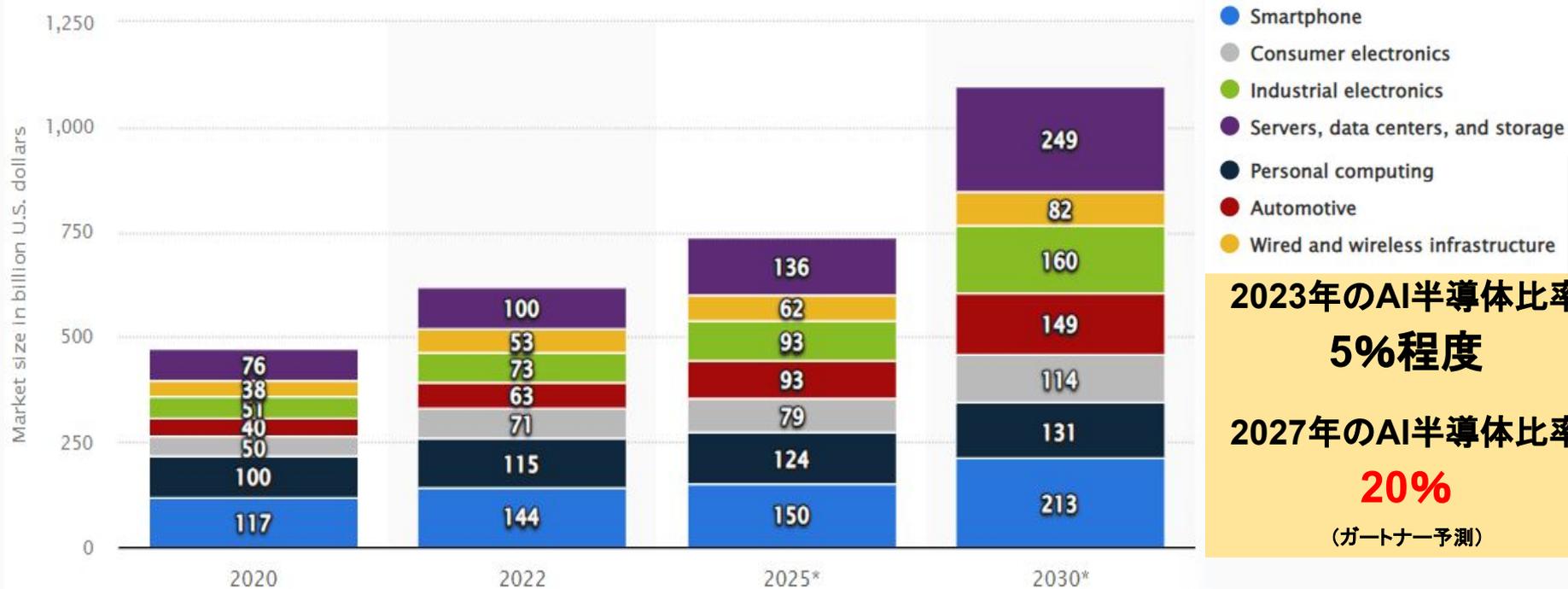
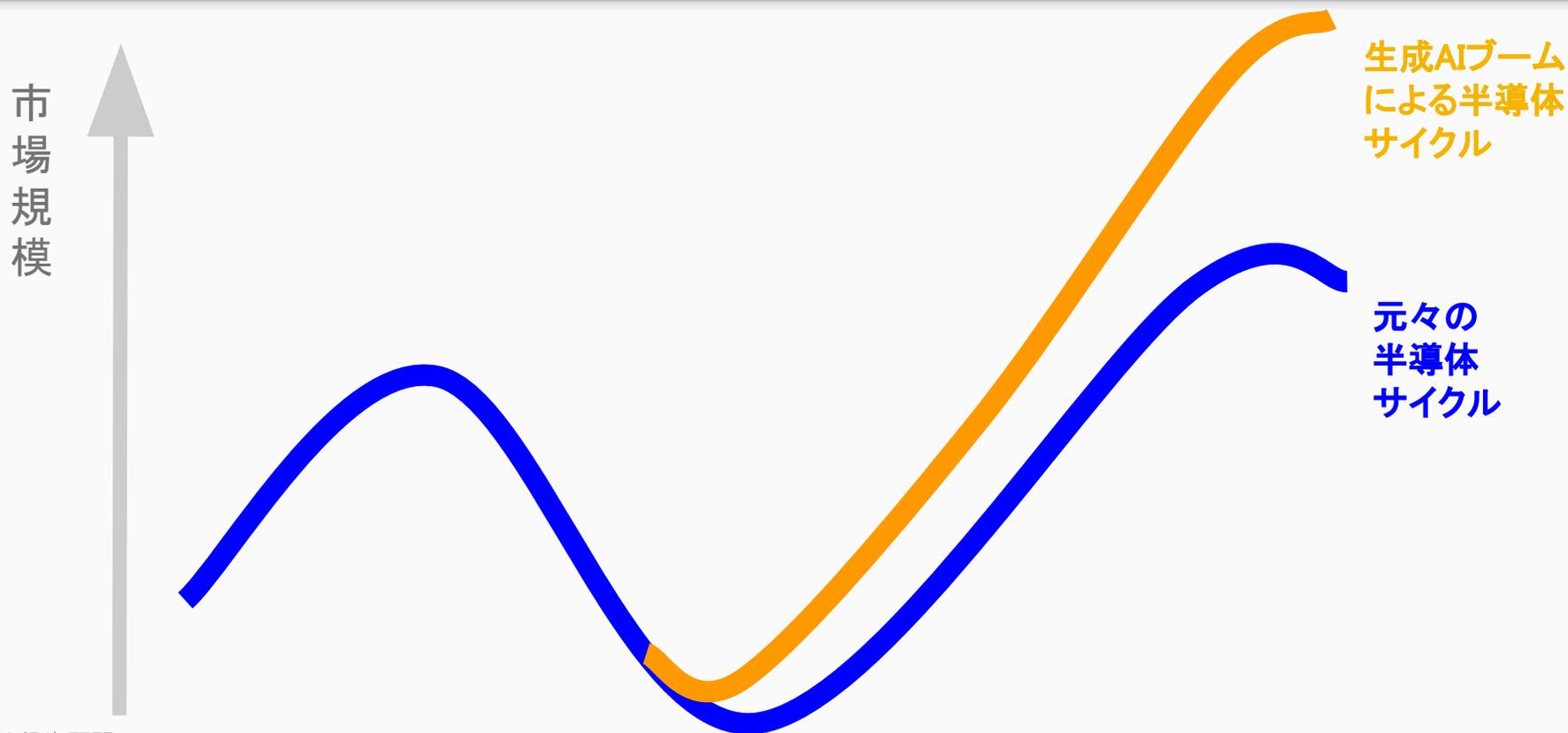


2030年には半導体市場は今の約2倍になると言われている

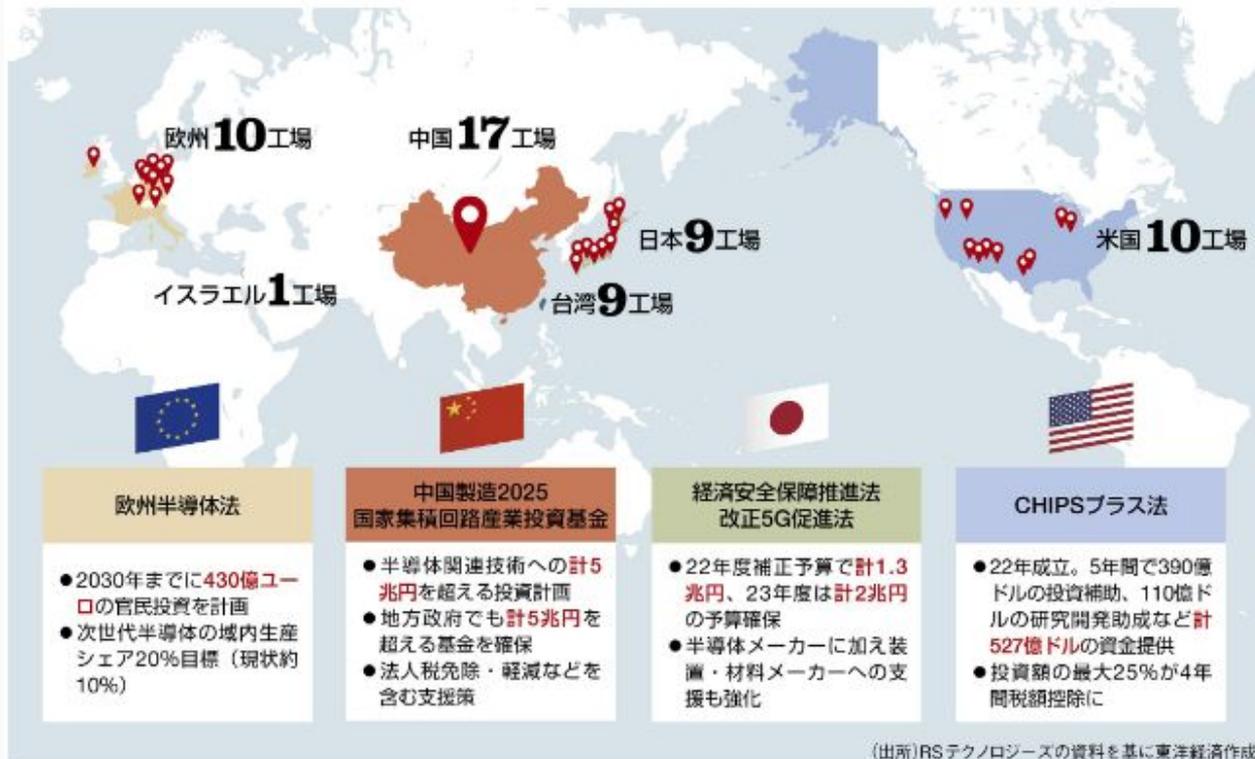


市場は、生成AIによってこうなる？



各国で半導体工場建設が計画

各国の巨額支援で半導体工場の建設が計画されている



(出所)RSテクノロジーズの資料を基に東洋経済作成

足元の需給バランスは濃淡あり。

供給 不足 ← バランス → 供給 過剰

在庫調整が進み半導体需給が改善

	2023年		24年		
	10~12月	1~3月	4~6	7~9	10~12
用途別	パソコン	↓	↓	→	↗
	スマートフォン	↓	↓	→	→
	生成AI向けデータセンター	↗	↗	↑	↑
	自動車	→	→	→	→
種類別	メモリー	↓	↓	→	↗
	先端ロジック	→	→	→	↗
	パワー	→	→	→	↗
	アナログ	→	→	→	→

やみくもに半導体銘柄に手を出すのは危険

日本は製造装置、素材で強みアリ。

製造装置 (9兆円)		素材 (6兆円)	
 (成膜・エッチング：1.5兆円)	 (露光：1.4兆円)	 (シリコンウェハー：3,500億円 レジスト：260億円)	 (シリコンウェハ：2,700億円)
 (エッチング：1.1兆円)	 TOKYO ELECTRON (塗布/現像：1.1兆円)	 (洗浄：0.2兆円)	 (シリコンウェハ：2,400億円)
		 (シリコンウェハ：1,900億円)	 (レジスト：400億円)

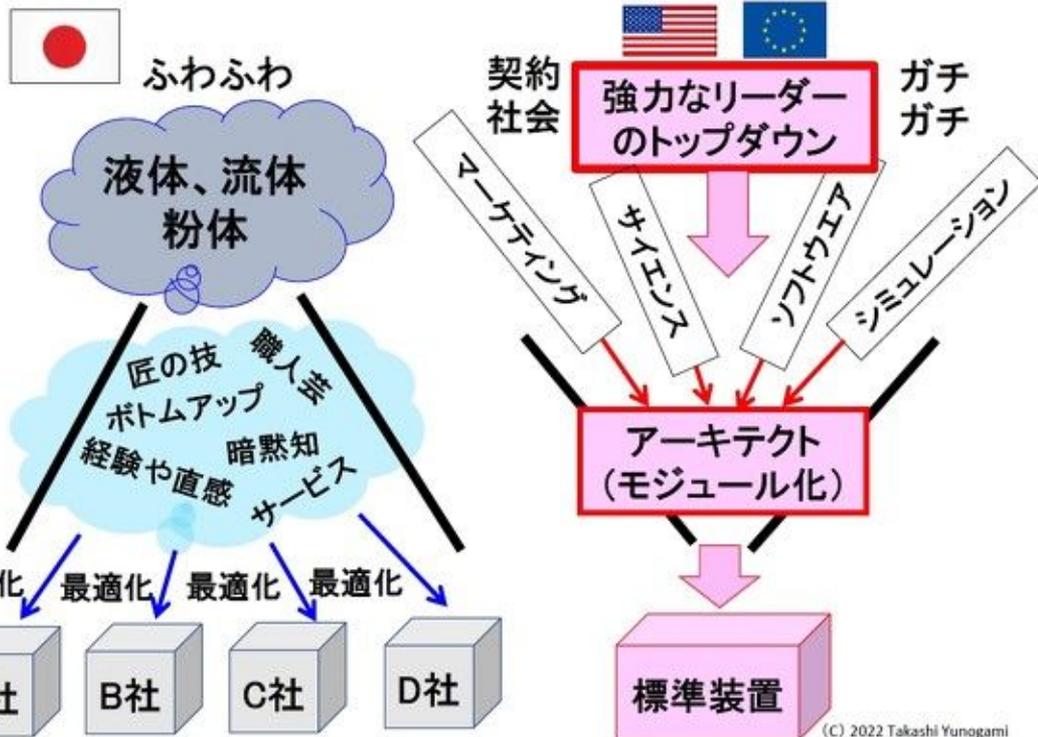
ここだけは譲らねえ！



その他 (15兆円)	【パワー半導体等】
	 (4,000億円)  (1,500億円)  (1,000億円)  (600億円)  (900億円)
	 (9,000億円)  (3,000億円)  (1,900億円)  (1,900億円)
 (1.1兆円)  (6千億円)  (4千億円)  (2千億円)	

出典：経産省

日本企業は「ふわふわ」に強み。



■日本の製造装置・材料の特徴

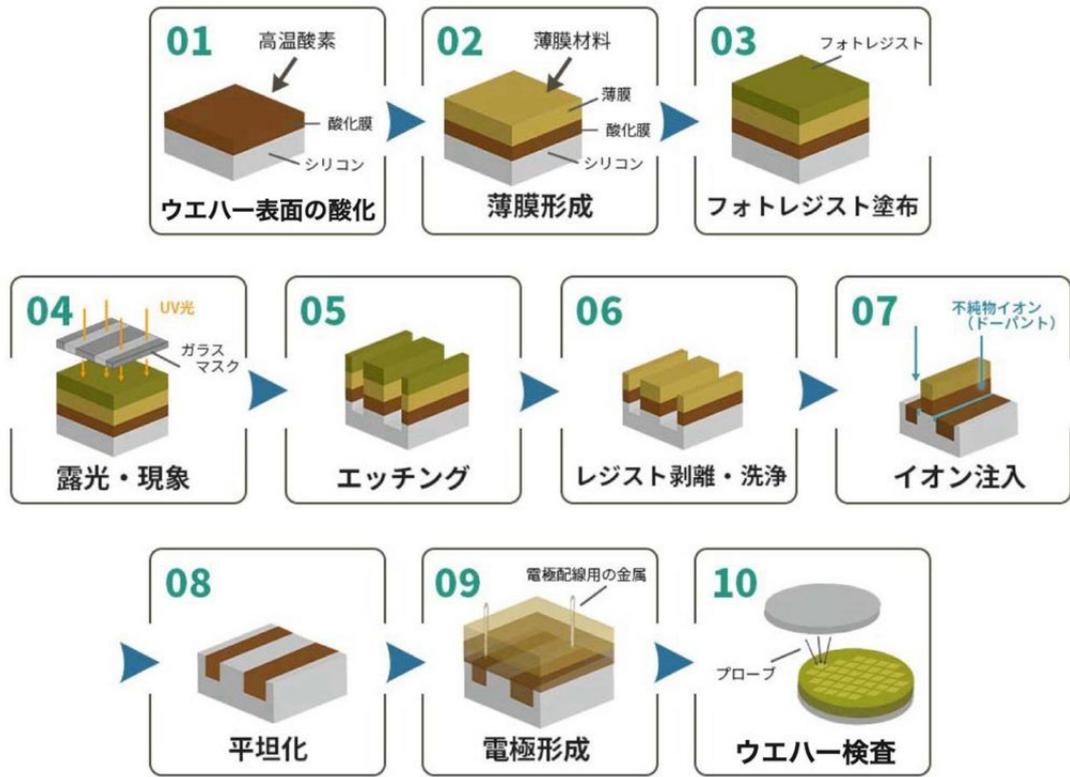
- ①液体(または気体などの流体)に関する装置/材料のシェアが高い。
- ②熱をかけて固めた材料や部品のシェアが高い。
- ③ドライな装置の日本シェアは低い。

すり合わせ VS 組み合わせ

アート VS サイエンス
(芸術) (原理・法則)

すり合わせ、アートの領域を極めた製造装置・材料企業に投資
妙味がある。

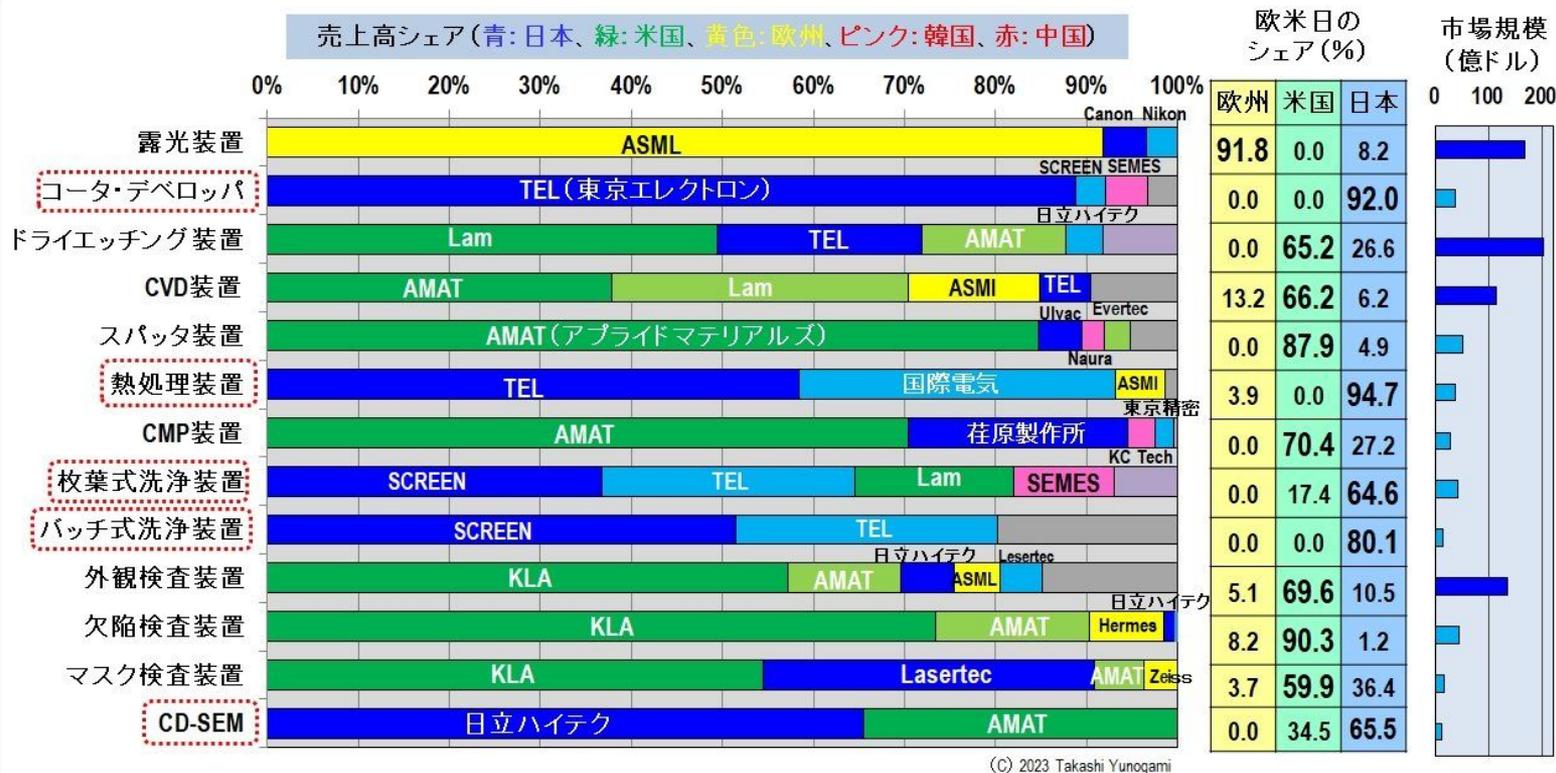
先端品程、前工程（回路をウエハに描く）プロセスが増える。
⇒製造装置や材料の需要も増える。



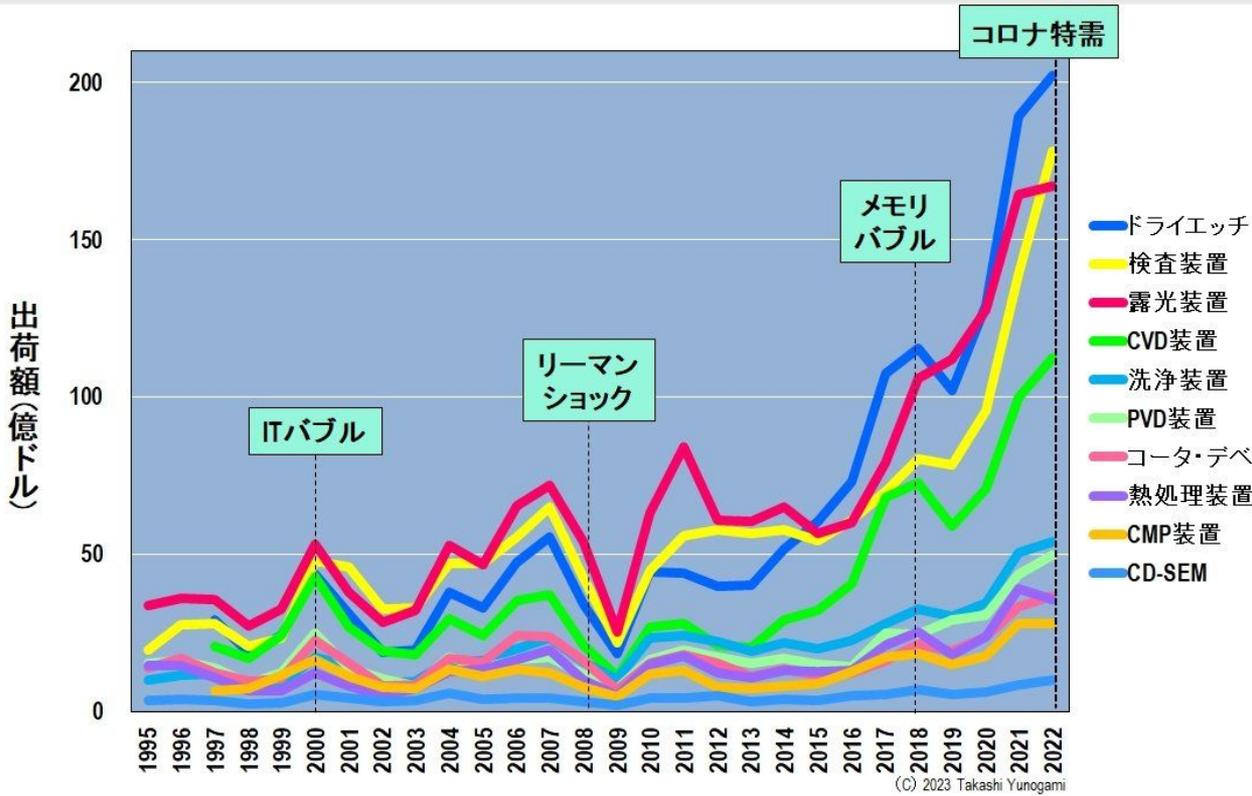
先端半導体程、
「03～08」
の繰り返し工数が
激増する。

完成品のテスター需要
も増える。

半導体製造装置でも、ふわふわ領域が強い。



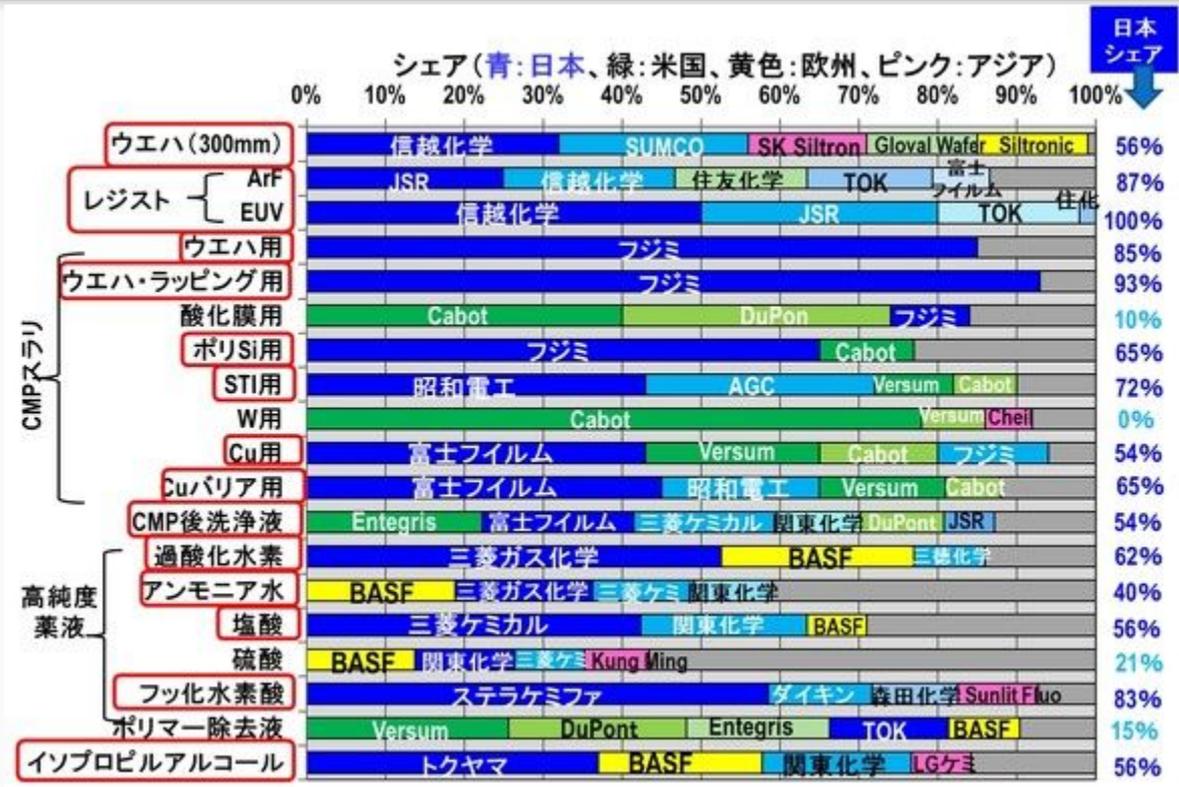
半導体製造装置全般出荷額が増えているが、濃淡がある。



製造装置は、信頼や実績が重要視されるため、スイッチングコストが高い。

ドライエッチング: 東エレ
検査装置: レーザーテック
洗浄装置: SCREEN
東エレ

前工程の材料メーカーや、その原料メーカーも強い。 やはり、「ふわふわ」がポイント。



材料及びその原料でも、
匠の技術と、高純度が
求められる。

「ふわふわ」は、粘り強い日本人が得意とする領域。技術優位性は高い。

※材料の原料メーカーも強い。